

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 4 月 5 日(05.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/043608 A1

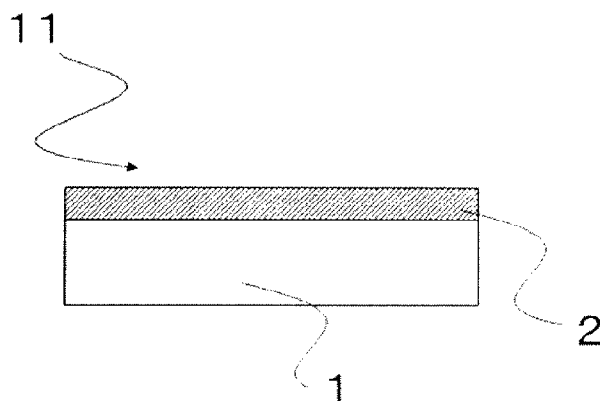
- (51) 国際特許分類:
B65D 73/02 (2006.01) B65D 85/86 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/072150
- (22) 国際出願日: 2011 年 9 月 28 日(28.09.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-221536 2010 年 9 月 30 日(30.09.2010) JP
特願 2011-072187 2011 年 3 月 29 日(29.03.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 増井 健 (MASUI Ken) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 平松 正幸 (HIRAMATSU Masayuki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 棚井 澄雄, 外 (TANAI Sumio et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: COVER TAPE FOR PACKAGING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 電子部品包装用カバーテープ

[図1]



(57) Abstract: The present invention provides a cover tape for packaging electronic components which has suitable transparency and can be inhibited from causing static buildup when separated from the carrier tape. This cover tape for packaging electronic components comprises a base layer and a heat sealant layer formed thereover, wherein the heat sealant layer comprises a polyolefin resin and a polyether/polyolefin copolymer. The weight proportion of the polyether/polyolefin copolymer in the heat sealant layer is 10-70 wt.%.

(57) 要約: 本発明により、好適な透明性を有するとともにキャリアテープからの剥離の際に発生する帯電を抑えることが可能な電子部品包装用カバーテープが提供される。本発明の電子部品包装用カバーテープは、基材層上にヒートシーラント層を備え、前記ヒートシーラント層がポリオレフィン系樹脂とポリエーテル/ポリオレフィン共重合体とを含む。前記ヒートシーラント層中のポリエーテル/ポリオレフィン共重合体の重量比率は、10重量%以上70重量%以下である。



WO 2012/043608 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))